

# 従来の製品開発の問題点と解決案

## ～開発者の悩み～

メモリの高速化によって  
製品設計の難易度が増大



- 複雑化する熱設計
- 増加する消費電力
- 高速化する伝送設計・EMI設計
- 短期化する開発期間



限られたリソース&短納期...  
コストはかけられない、  
失敗できない



## ～解決案～

FCRAMにより  
設計リスクとコストを削減！

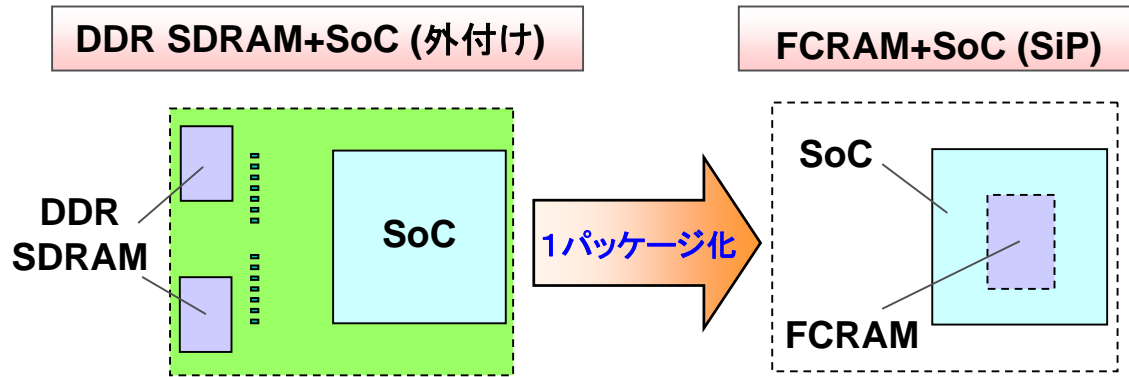
### FCRAM SiPの利点

- 低消費電力メモリシステムを構築
- 低周波数のため、EMI対策が容易
- PCBコストを削減
- PCB設計リスク解消
- PCB設計リソース不要



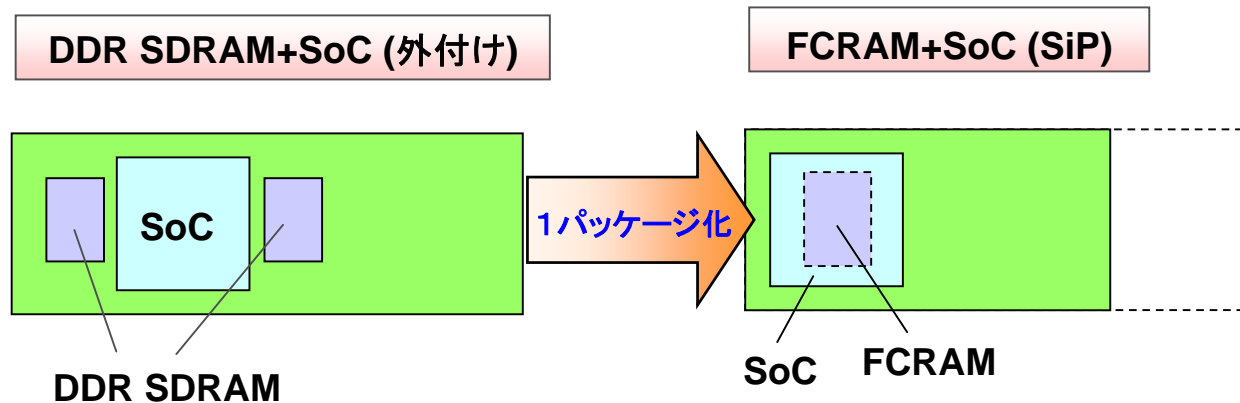
# SiPによるアプリケーション別の解決案

## ● デジタルテレビ向けSiPソリューション



- 利点
  - 熱対策コストとリスクの最小化
  - PCBコストとPCB開発リスクの低減
  - メモリの使用個数の減少によるコストの削減

## ● デジタルビデオカメラ向けSiPソリューション



- 利点
  - PCB実装面積の削減による製品デザインの柔軟性
  - PCBコストとPCB開発リスクの低減
  - メモリの使用個数の減少によるコストの削減